



RoHS 排外條款大幅修訂 - 2010/571/EU

歐盟執委會於 2010 年 9 月 24 日公佈 2010/571/EU，大幅修訂歐盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 之排外項目。

經審核後，執委會認為某些應用含有鉛、汞或鎘等物質，於現今的科學或技術上證據足以證明可被消除或取代，或者在可預見的未來可達成此目的。因此，有必要為先前所設置的排外條款進行刪除或者設定一到期日。

為達到以上之目的，歐盟執委會公佈 2010/571/EU，重新明定每個排外項目內容或為此設定排外適用到期日。該修訂版本生效後，將正式取代原先 RoHS 指令之排外條款。詳細內容請見以下表格。(附註: 與原先法規不同，有變動之處，以藍字標示)

Intertek 提供 RoHS 完整測試服務，包含化學濕式分析、XRF 篩選、RoHS 產品符合性評估、RoHS 產品認證 (PCS)、RoHS 法規諮詢與教育訓練等服務。

服務電話：

台北：02-66022888

分機 220 陳祺雯 小姐

分機 247 范宇翔 先生

高雄：07-5369895

分機 17 郭世明 先生

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.
全國公證檢驗股份有限公司
8F., No 423, Ruiguang Road, Nei Hu Dist.,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
台北市 114 內湖區瑞光路 423 號 8F
TEL : (886-2) 6602-2888
FAX : (886-2) 6602-2889
Http:// www.intertek-twn.com

	排外項目	適用範圍及日期
1	單端省電燈管中所使用的汞含量不得超過 (每個燈):	
1(a)	一般照明用途 < 30 W: 5 毫克 (mg)	到期日：2011 年 12 月 31 日 3.5 mg：2011 年 12 月 31 日之後至 2012 年 12 月 31 日 2.5 mg：2011 年 12 月 31 日之後
1(b)	一般照明用途 ≥ 30 W 且 < 50 W: 5 毫克 (mg)	到期日：2011 年 12 月 31 日 3.5 mg：2011 年 12 月 31 日之後
1(c)	一般照明用途 ≥ 50 W 且 < 150 W: 5 毫克 (mg)	
1(d)	一般照明用途 ≥ 150 W: 15 毫克 (mg)	

排外項目		適用範圍及日期
1(e)	一般照明用途，為圓形或方形結構，且管徑 ≤ 17 mm	到期日：2011年12月31日 7 mg：2011年12月31日之後
1(f)	特殊用途: 5 mg	
2(a)	用於一般照明之雙端直線型省電燈管中，所使用的汞含量不得超過 (每個燈管):	
2(a)(1)	一般壽命之三波長螢光燈，其管徑 < 9 mm (例如 T2): 5 mg	到期日：2011年12月31日 4 mg：2011年12月31日之後
2(a)(2)	一般壽命之三波長螢光燈，其管徑 ≥ 9 mm 且 ≤ 17 mm (例如 T5): 5 mg	到期日：2011年12月31日 3 mg：2011年12月31日之後
2(a)(3)	一般壽命之三波長螢光燈，其管徑 > 17 mm 且 ≤ 28 mm (例如 T8): 5 mg	到期日：2011年12月31日 3.5 mg：2011年12月31日之後
2(a)(4)	一般壽命之三波長螢光燈，其管徑 > 28 mm (例如 T12): 5 mg	到期日：2011年12月31日 3.5 mg：2011年12月31日之後
2(a)(5)	長壽命($\geq 25\,000$ h) 之三波長螢光燈: 8 mg	到期日：2011年12月31日 5 mg：2011年12月31日之後
2(b)	用於其他螢光燈管中，所使用的汞含量不得超過 (每個燈管):	
2(b)(1)	直線型磷酸鹽燈管，其管徑 > 28 mm (例如 T10 and T12): 10 mg	到期日：2012年4月13日
2(b)(2)	非直線型磷酸鹽燈管 (所有管徑 all diameters): 15 mg	到期日：2016年4月13日
2(b)(3)	非直線型三波長螢光燈，其管徑 > 17 mm (例如 T9)	無使用限制：2011年12月31日前 15 mg：2011年12月31日之後
2(b)(4)	其他一般照明或者特殊用途燈 (例如: 感應燈)	無使用限制：2011年12月31日 15 mg：2011年12月31日之後
3	特殊用途之冷陰極螢光燈 (CCFL) 及外部電極螢光燈 (EEFL)，所使用的汞含量不得超過 (每個燈管):	
3(a)	較短長度 (≤ 500 mm)	無使用限制：2011年12月31日 3.5 mg：2011年12月31日之後
3(b)	中等長度 (> 500 mm and $\leq 1\,500$ mm)	無使用限制：2011年12月31日 5 mg：2011年12月31日之後
3(c)	較長長度 ($> 1\,500$ mm)	無使用限制：2011年12月31日 15 mg：2011年12月31日之後
4(a)	其他低壓放電燈 (每個燈管)	無使用限制：2011年12月31日 15 mg：2011年12月31日之後
4(b)	一般照明用途之高壓鈉 (蒸氣) 燈，其演色性指數 $R_a > 60$ ，所使用的汞含量不得超過 (每個燈):	
4(b)-I	$P \leq 155$ W	無使用限制：2011年12月31日 30 mg：2011年12月31日之後

排外項目		適用範圍及日期
4(b)-II	155 W < P ≤ 405 W	無使用限制：2011 年 12 月 31 日 40 mg：2011 年 12 月 31 日之後
4(b)-III	P > 405 W	無使用限制：2011 年 12 月 31 日 40 mg：2011 年 12 月 31 日之後
4(c)	一般照明用途之高壓鈉 (蒸氣) 燈，所使用的汞含量不得超過 (每個燈):	
4(c)-I	P ≤ 155 W	無使用限制：2011 年 12 月 31 日 25 mg：2011 年 12 月 31 日之後
4(c)-II	155 W < P ≤ 405 W	無使用限制：2011 年 12 月 31 日 30 mg：2011 年 12 月 31 日之後
4(c)-III	P > 405 W	無使用限制：2011 年 12 月 31 日 40 mg：2011 年 12 月 31 日之後
4(d)	高壓汞 (蒸氣) 燈 (HPMV) 中所含的汞:	到期日：2015 年 4 月 13 日
4(e)	複金屬燈 (MH) 中所含的汞:	
4(f)	其他未在此附錄中所提及之特殊用途放電燈，其所含之汞	
5(a)	陰極射線管中的玻璃可含鉛	
5(b)	螢光管中所含的鉛不得超過其重量之 0.2%	
6(a)	鉛用於加工用途之鋼材及鍍鋅鋼的合金元素之一，其含量最高可達 0.4%	
6(b)	鉛用於鋁合金，並為其元素之一，含量最高可達 0.4%	
6(c)	銅合金中所含的鉛，最高可達 4%	
7(a)	高熔點類之錒錫可含鉛 (如鉛為基底的合金, 其鉛含量大於 85%)	
7(b)	於伺服器、儲存裝置或儲存陣列系統裝置中使用的錒錫，或於架設網路配備中用到的如開關，信號裝置、傳輸裝置或電信網路配備中所會用到的錒錫可含鉛。	
7(c)-I	鉛用於電器及電子元件中之玻璃或陶瓷 (介電陶瓷電容除外)。例如: 壓電元件或者玻璃/陶瓷複合材料	
7(c)-II	額定電壓為 125 V AC or 250 V DC 或者更高之介電陶瓷電容中所含的鉛	
7(c)-III	額定電壓低於 125 V AC or 250 V DC 的介電陶瓷電容中所含的鉛	到期日：2013 年 1 月 1 日 之後僅能適用於 2013 年 1 月 1 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
8(a)	鎘及鎘化合物可用於溫度保險絲中。	到期日：2012 年 1 月 1 日 之後僅能適用於 2012 年 1 月 1 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
8(b)	鎘及其化合物可用於電子接點。	

排外項目		適用範圍及日期
9	六價鉻用於吸收式冷藏櫃碳鋼冷卻系統中的防腐蝕劑，其重量佔冷卻液 0.75%。	
9(b)	冷暖空調設備 (HVACR) 中的軸承殼及軸襯可含鉛。	
11(a)	C-press 順應針(compliant pin) 連接器系統中的應用可含鉛。	僅能適用於 2010 年 9 月 24 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
11(b)	除了 C-press 之外的順應針(compliant pin)連接器系統中所使用的鉛。	到期日：2013 年 1 月 1 日 之後僅能適用於 2013 年 1 月 1 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
12	導熱模組 C-ring 中的塗布材質可含鉛。	僅能適用於 2010 年 9 月 24 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
13(a)	光學應用之玻璃中可含鉛。	
13(b)	濾光玻璃及用來當做反射率標準片的玻璃中可含鎘與鉛。	
14	用於連接接腳及封裝後的微處理器的鉍錫，若此鉍錫為兩種以上之元素組成，則其含鉛量可介於 80%~85% 之間。	到期日：2011 年 1 月 1 日 之後僅能適用於 2011 年 1 月 1 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
15	用於積體電路覆晶封裝流程中，為連接半導體晶片及載體間，以完成電力連結的鉍錫可含鉛。	
16	直立式的鎢絲燈，若其燈管含有矽酸鹽塗佈，則可含鉛。	Expires on 1 September 2013
17	鹵化鉛作為發光源，並用於專業複印設備的 HID 燈中，則可含鉛。	
18(a)	特殊用途之放電燈，例如用於含二氮化合物之電子翻印、平板印刷、補蟲燈、光化學或樹脂硬化過程，其中含有磷，例如 SMS ((Sr,Ba) ₂ MgSi ₂ O ₇ :Pb)，則放電燈中的螢光粉，其鉛作為觸發源，鉛含量可佔 1%或更少。	到期日：2011 年 1 月 1 日
18(b)	仿日曬之放電燈，其中含有磷，例如 BSP (BaSi ₂ O ₅ :Pb)，則放電燈中的螢光粉，其鉛作為觸發源，鉛含量可佔 1%或更少。	
19	鉛作為汞齊 (即汞合金) 中的特定成分，如 PbBiSn-Hg 或 PbInSn-Hg 中，且此汞齊作為主要汞齊，或如 PbSn-Hg 用於輔助汞齊中，且這些汞齊使用於節能燈泡(ESL) 中，則可含鉛。	到期日：2011 年 6 月 1 日
20	LCD 中用於保護平面螢光燈之前後支撐物的玻璃中可含氧化鉛。	到期日：2011 年 6 月 1 日
21	用於硼矽酸鹽玻璃瓷漆的印墨所含的鉛及鎘	
23	鉛用於細間距零件零件之表面處理，但不包括間距等於或小於 0.65mm 之連接器。	僅能適用於 2010 年 9 月 24 日前就已置於市場上的電子電機產品之備用零件
24	通孔盤狀及平面陣列陶瓷多層電容器焊料所含的鉛	
25	表面傳導式電子發射顯示器 (SED) 的構件所用的氧化鉛，尤其是密封玻璃 (seal frit) 及 玻璃環 (frit ring) 中。	
26	紫外線藍黑燈管 (BLB)玻璃外罩所含的氧化鉛	到期日：2011 年 6 月 1 日

排外項目		適用範圍及日期
27	在大功率揚聲器 (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) 中作為轉換器焊料的鉛合金	到期日：2010年9月24日
29	第 69/493/EEC 號指令附件 1(第一、二、三及四類所指水晶玻璃含有的鉛)	
30	音壓大於 100dB(A) 的大功率揚聲器中，與音圈轉換器連接電導體之電機/機械鍍料中的鎳合金。	
31	無汞平板螢光燈(例如用於液晶螢幕、設計或工業照明)中的鍍料所含的鉛。	
32	氫及氮雷射管中，使用於視窗結構的密封玻璃中的氧化鉛。	
33	用以焊接電源變壓器中直徑 100 微米及以下的幼身銅線的焊料中的鉛	
34	水泥製微調電位器組件中的鉛	
36	直流等離子顯示器中，作為陰極濺射抑制劑中的汞含量最高可達 30 毫克	到期日：2010年7月1日
37	以硼酸鋅玻璃體為基礎的高壓二極體的電鍍層的鉛含量	
38	用氧化鉍連接鋁製成的厚膜漿料中鎳和氧化鎳的含量	
39	應用於固態照明或顯示系統中的彩色轉換 II-VI 族 LEDs 內所含的鎳 (鎳含量 < 10 μg/mm ² 的發光面積)	到期日：2014年7月1日

亞太區聯繫方式

中國 - 上海, Tel: +86 21 6120 6565 #6236, E-mail: allen.lv@intertek.com

中國 - 深圳, Tel: +86 755 2602 0086, E-mail: susan.fu@intertek.com

中國 - 天津, Tel: +86 22 8371 3406, E-mail: leon.lv@intertek.com

中國 - 無錫, Tel: +86 21 6120 6565 #6236, E-mail: allen.lv@intertek.com

中國 - 香港, Tel: +852 2173 8770, E-mail: denise.chan@intertek.com

台灣, Tel: +886 2 6602 2220, E-mail: queena.chen@intertek.com

泰國, Tel: +66 2 939 0661 #801, E-mail: komson.praditthakorn@intertek.com

馬來西亞, Tel: +60 3 3176 6179, E-mail: jesslyn.teow@intertek.com

新加坡, Tel: +65 6381 0625, E-mail: mary.chua@intertek.com

印尼, Tel: +65 6381 0625, E-mail: rika.hinardi@intertek.com

韓國, Tel: +82 2 2109 1250, E-mail: jack.kim@intertek.com

印度, Tel: +91 80 4021 3752, E-mail: gururaj.mirji@intertek.com

菲律賓, Tel: +632 819 5841, E-mail: cecille.sanchez@intertek.com

日本, Tel: +81 6 6303 1653, E-mail: christine.tam@intertek.com

Web: www.intertek.com/rohs E-mail: rohs@intertek.com

Disclaimer

Intertek made all reasonable efforts to ensure the accuracy of the information. However, the information provided should not be relied upon as legal advice or regarded as a substitute for legal advice. The reader should exercise his own care and judgment before relying on this information in any important matter.

Copyright © 2009 Intertek Group. All Rights Reserved.

Significant Changes in RoHS exemptions (2010/571/EU)

European Commission published the EU 2010/571/EU to amend the exemption of RoHS Directive (2002/95/EC) on September 24.

As a result of the review of the exemptions, for certain applications containing lead, mercury, or cadmium the elimination or substitution of the use of those substances has become scientifically or technically possible, and certain applications containing lead, mercury or cadmium, the elimination or substitution of the use of those substances will become scientifically or technically possible in the foreseeable future. So It is therefore appropriate to delete or set expiry dates for those exemptions.

The Annex of RoHS exemption is replaced by 2010/571/EU. The detailed exemptions as following table. (Note: The revised content marked in blue color.)

Exemption		Scope and dates of applicability
1	Mercury in single capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner):	
1(a)	For general lighting purposes < 30 W: 5 mg	Expires on 31 December 2011; 3,5 mg may be used per burner after 31 December 2011 until 31 December 2012; 2,5 mg shall be used per burner after 31 December 2012
1(b)	For general lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W: 5 mg	Expires on 31 December 2011; 3,5 mg may be used per burner after 31 December 2011
1(c)	For general lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W: 5 mg	
1(d)	For general lighting purposes ≥ 150 W: 15 mg	
1(e)	For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter ≤ 17 mm	No limitation of use until 31 December 2011; 7 mg may be used per burner after 31 December 2011
1(f)	For special purposes: 5 mg	
2(a)	Mercury in double-capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp):	
2(a)(1)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 5 mg	Expires on 31 December 2011; 4 mg may be used per lamp after 31 December 2011
2(a)(2)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 5 mg	Expires on 31 December 2011; 3 mg may be used per lamp after 31 December 2011
2(a)(3)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (e.g. T8): 5 mg	Expires on 31 December 2011; 3,5 mg may be used per lamp after 31 December 2011
2(a)(4)	Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 5 mg	Expires on 31 December 2011; 3,5 mg may be used per lamp after 31 December 2011
2(a)(5)	Tri-band phosphor with long lifetime ($\geq 25\ 000$ h): 8 mg	Expires on 31 December 2011; 5 mg may be used per lamp after 31 December 2011

Exemption		Scope and dates of applicability
2(b)	Mercury in other fluorescent lamps not exceeding (per lamp):	
2(b)(1)	Linear halophosphate lamps with tube > 28 mm (e.g. T10 and T12): 10 mg	Expires on 13 April 2012
2(b)(2)	Non-linear halophosphate lamps (all diameters): 15 mg	Expires on 13 April 2016
2(b)(3)	Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g. T9)	No limitation of use until 31 December 2011; 15 mg may be used per lamp after 31 December 2011
2(b)(4)	Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps)	No limitation of use until 31 December 2011; 15 mg may be used per lamp after 31 December 2011
3	Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for special purposes not exceeding (per lamp):	
3(a)	Short length (≤ 500 mm)	No limitation of use until 31 December 2011; 3,5 mg may be used per lamp after 31 December 2011
3(b)	Medium length (> 500 mm and $\leq 1\ 500$ mm)	No limitation of use until 31 December 2011; 5 mg may be used per lamp after 31 December 2011
3(c)	Long length (> 1 500 mm)	No limitation of use until 31 December 2011; 13 mg may be used per lamp after 31 December 2011
4(a)	Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp)	
4(b)	Mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index $R_a > 60$:	
4(b)-I	$P \leq 155$ W	No limitation of use until 31 December 2011; 30 mg may be used per burner after 31 December 2011
4(b)-II	155 W < $P \leq 405$ W	No limitation of use until 31 December 2011; 40 mg may be used per burner after 31 December 2011
4(b)-III	$P > 405$ W	No limitation of use until 31 December 2011; 40 mg may be used per burner after 31 December 2011
4(c)	Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding (per burner):	
4(c)-I	$P \leq 155$ W	No limitation of use until 31 December 2011; 25 mg may be used per burner after 31 December 2011
4(c)-II	155 W < $P \leq 405$ W	No limitation of use until 31 December 2011; 30 mg may be used per burner after 31 December 2011
4(c)-III	$P > 405$ W	No limitation of use until 31 December 2011; 40 mg may be used per burner after 31 December 2011

Exemption		Scope and dates of applicability
4(d)	Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV)	Expires on 13 April 2015
4(e)	Mercury in metal halide lamps (MH)	
4(f)	Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annex	
5(a)	Lead in glass of cathode ray tubes	
5(b)	Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0,2 % by Weight	
6(a)	Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized steel containing up to 0,35 % lead by weight	
6(b)	Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight	
6(c)	Copper alloy containing up to 4 % lead by weight	
7(a)	Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85 % by weight or more lead)	
7(b)	Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission, and network management for telecommunications	
7(c)-I	Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other than dielectric ceramic in capacitors, e.g. piezoelectronic devices, or in a glass or ceramic matrix compound	
7(c)-II	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V DC or higher	
7(c)-III	Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of less than 125 V AC or 250 V DC	Expires on 1 January 2013 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2013
8(a)	Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs	Expires on 1 January 2012 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2012
8(b)	Cadmium and its compounds in electrical contacts	
9	Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators up to 0,75 % by weight in the cooling solution	
9(b)	Lead in bearing shells and bushes for refrigerant-containing compressors for heating, ventilation, air conditioning and refrigeration (HVACR) applications	
11(a)	Lead used in C-press compliant pin connector systems	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010
11(b)	Lead used in other than C-press compliant pin connector systems	Expires on 1 January 2013 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2013

Exemption		Scope and dates of applicability
12	Lead as a coating material for the thermal conduction module C-ring	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010
13(a)	Lead in white glasses used for optical applications	
13(b)	Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards	
14	Lead in solders consisting of more than two elements for the connection between the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 80 % and less than 85 % by weight	Expires on 1 January 2011 and after that date may be used in spare parts for EEE placed on the market before 1 January 2011
15	Lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages	
16	Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes	Expires on 1 September 2013
17	Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID) lamps used for professional reprography applications	
18(a)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as speciality lamps for diazoprinting reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba) ₂ MgSi ₂ O ₇ :Pb)	Expires on 1 January 2011
18(b)	Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi ₂ O ₅ :Pb)	
19	Lead with PbBiSn-Hg and PblnSn-Hg in specific compositions as main amalgam and with PbSn-Hg as auxiliary amalgam in very compact energy saving lamps (ESL)	Expires on 1 June 2011
20	Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent lamps used for Liquid Crystal Displays (LCDs)	Expires on 1 June 2011
21	Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses, such as borosilicate and soda lime glasses	
23	Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 0,65 mm and less	May be used in spare parts for EEE placed on the market before 24 September 2010
24	Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal and planar array ceramic multilayer capacitors	
25	Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED) used in structural elements, notably in the seal frit and frit ring	
26	Lead oxide in the glass envelope of black light blue lamps	Expires on 1 June 2011
27	Lead alloys as solder for transducers used in high-powered (designated to operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above) loudspeakers	Expired on 24 September 2010
29	Lead bound in crystal glass as defined in Annex I (Categories 1, 2, 3 and 4) of Council Directive 69/493/EEC ⁽¹⁾	

Exemption		Scope and dates of applicability
30	Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A) and more	
31	Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays, design or industrial lighting)	
32	Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton laser tubes	
33	Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 µm diameter and less in power transformers	
34	Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements	
36	Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with a content up to 30 mg per display	Expired on 1 July 2010
37	Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate glass body	
38	Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminium bonded beryllium oxide	
39	Cadmium in colour converting II-VI LEDs (< 10 µg Cd per mm ² of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems	Expires on 1 July 2014

APAC Contact

China – Shanghai, Tel: +86 21 6120 6565 #6236, E-mail: allen.lv@intertek.com

China – Shenzhen, Tel: +86 755 2602 0086, E-mail: susan.fu@intertek.com

China – Tianjin, Tel: +86 22 8371 3406, E-mail: leon.lv@intertek.com

China – Wuxi, Tel: +86 21 6120 6565 #6236, E-mail: allen.lv@intertek.com

China – Hong Kong, Tel: +852 2173 8770, E-mail: denise.chan@intertek.com

Taiwan, Tel: +886 2 6602 2220, E-mail: queena.chen@intertek.com

Thailand, Tel: +66 2 939 0661 #801, E-mail: komson.praditthakorn@intertek.com

Malaysia, Tel: +60 3 3176 6179, E-mail: jesslyn.teow@intertek.com

Singapore, Tel: +65 6381 0625, E-mail: mary.chua@intertek.com

Indonesia, Tel: +65 6381 0625, E-mail: rika.hinardi@intertek.com

Korea, Tel: +82 2 2109 1250, E-mail: jack.kim@intertek.com

India, Tel: +91 80 4021 3752, E-mail: gururaj.mirji@intertek.com

Philippines, Tel: +632 819 5841, E-mail: cecille.sanchez@intertek.com

JAPAN, Tel: +81 6 6303 1653, E-mail: christine.tam@intertek.com

Web: www.intertek.com/rohs **E-mail:** rohs@intertek.com

Disclaimer

Intertek made all reasonable efforts to ensure the accuracy of the information. However, the information provided should not be relied upon as legal advice or regarded as a substitute for legal advice. The reader should exercise his own care and judgment before relying on this information in any important matter.
Copyright © 2009 Intertek Group. All Rights Reserved.